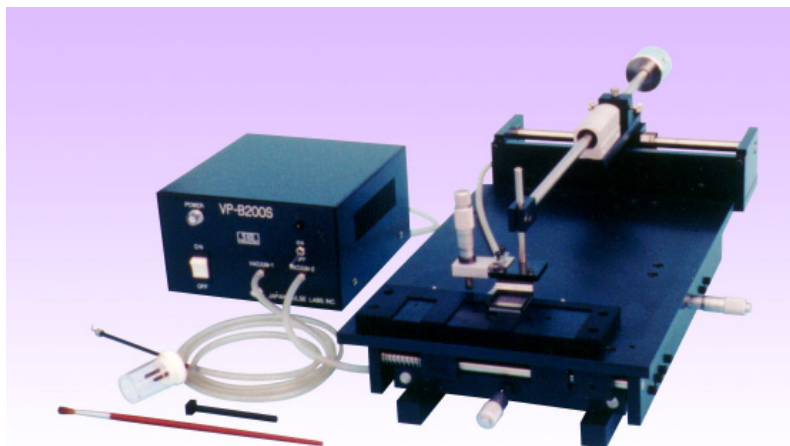




BGA
CSP
MCM

Balling
Re-Balling

(マイクロ・スクリーンは別売です)

簡易ボールマウンター SP-100BR

SP-100BRはマイクロ・スクリーン(μ S-100series、別売)を用いて、BGA、CSPやMCMなどのパッケージにボール端子を生成(Mount)する装置です。48pinのCSPから1500pinのMCMまで、0.4mm ϕ から0.89mm ϕ のボールに対応できます。リワークしたパッケージのボール再生や、開発途中のチップのボール付けなど少量のパッケージに、簡単にボール端子を生成できます。

特 長

- 48pinのCSPから1500pinのBGAやMCMまで、0.4mm ϕ から0.89mm ϕ のボールに対応します。(マイクロ・スクリーンは別売です)
- この一台でフラックスやクリームはんだの印刷と、ボールの整列ができます。(クリームはんだ印刷用とボールはんだ整列用のスクリーンが必要。スクリーンを交換して使用する。)
- スクリーンの位置(X,Y,Z)はマイクロメーターにより、10 μ mの精度で微調整できます。
- チップ固定用真空源内蔵で、AC100Vのみで使用できます。
- ボール整列後すぐにボールをリフローはんだ付けできる、手動式N₂リフロー装置RF-110N2もあります。
(高温 290)のボールはんだ用リフロー治具も用意できます)

仕 様

- ・ μ S-100series(別売)
 - ・ サイズ : 14 × 28mm ~ 54 × 63mm(7種類)
 - ・ スクリーン厚 : 0.15mm(CSPIは0.13mm)
 - ・ 材質 : フレーム SPCC
スクリーン SUS304
- ・ X,Y,Z微調整 : 15mm(分解能10 μ m)
- ・ 形状寸法・重量 : 本体 (W 250 × (L) 450 × (H) 160mm 8kg
制御BOX(W 180 × (D) 250 × (H) 110mm 3kg

対応パッケージ

- ・ サイズ : 6 × 6mm ~ 50 × 50mm
- ・ ピン数 : 48pin ~ 1500pin
- ・ ピッチ : 1.5mm ~ 0.5mm
- ・ ボール径 : 0.89mm ϕ ~ 0.4mm ϕ
- ・ ボールはんだ : 183 , 290

オプション(別売)

- ・ マイクロ・スクリーン : μ S-100series
- ・ 手動式リフローはんだ付け装置 : RF-110
RF-110N2
- ・ チップ吸着ステージ : 特注品

マイクロ・スクリーン μ S-100seriesの
カタログもご覧下さい。

本仕様は予告なく変更することがあります。